

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



HUA HONG SEMICONDUCTOR LIMITED

華虹半導體有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：1347)

**建議修訂期權的條款
及
建議更新股票期權計劃限額
及
暫停辦理股票過戶登記通告**

茲提述本公司於二零一五年九月一日採納的股票期權計劃以及本公司日期為二零一八年十二月二十七日、二零一九年三月二十九日及二零一九年十二月二十三日的公告，內容有關根據股票期權計劃授出期權。

於二零二一年十一月四日，董事會建議修訂二零一八年期權及二零一九年期權的條款。董事會亦建議更新股票期權計劃限額。根據上市規則第17.03(3)及(18)條以及股票期權計劃條款，該等建議均須獲股東批准。

建議修訂期權的條款

於二零一八年十二月二十四日，本公司根據股票期權計劃向本公司若干僱員及當時的董事授出34,500,000份期權，可認購合共最多34,500,000股股票。於二零一九年三月二十九日，本公司向本公司執行董事唐均君先生授出500,000份期權，可認購合共最多500,000股股票。於二零一九年十二月二十三日，本公司向本集團若干僱員進一步授出2,482,000份期權，可認購合共最多2,482,000股股票。

於本公告日期，本公司有21,077,209份未歸屬二零一八年期權及2,636,000份未歸屬二零一九年期權。

二零一八年期權及二零一九年期權的歸屬須待本公司達成若干戰略及財務表現目標(以(其中包括)本公司的銷售收入年複合增長率及本公司的年度息稅折舊及攤銷前利潤率計算)後,方可作實。該等表現目標由董事會釐定,並根據股票期權計劃於授出時在向各承授人發出的通知內訂明。

董事會建議修訂二零一八年期權及二零一九年期權的條款,使得各項財務表現目標(即本公司的銷售收入三年複合增長率及本公司的年度息稅折舊及攤銷前利潤率)將被賦予50%的加權比重,且在滿足其餘條件的前提下,達成任何一項財務表現目標將導致應於特定歸屬日期到期歸屬的期權50%歸屬。於釐定其年度息稅折舊及攤銷前利潤率時,本公司將視其研發開支為利潤,符合國務院國有資產監督管理委員會於其促進科技創新的政策導向。

董事會認為,建議修訂符合本公司及股東整體的利益,因為,其令本公司於獎勵其僱員的努力及貢獻時更具靈活性,預期將有助於激勵及保留本集團內的人才,與股票期權計劃的目的之一致。

建議修訂的詳情將載於將寄發予股東的通函內。

建議更新股票期權計劃限額

根據上市規則第17.03(3)條及股票期權計劃條款,在根據股票期權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有期權獲行使時可予發行的股票總數,合共不得超過於批准股票期權計劃當日的已發行股票總數的10%。

股東可於股東大會上更新股票期權計劃限額,惟:

1. 經更新股票期權計劃限額不得超過於批准經更新限額當日的已發行股票的10%;
2. 在計算經更新股票期權計劃限額時,此前根據股票期權計劃或本公司任何其他計劃已授出之期權(包括尚未行使、已註銷或失效期權及已行使期權)將不會計算在內;及
3. 在根據股票期權計劃及本公司任何其他計劃已授出但尚未行使之所有尚未行使期權獲行使時可予發行的股票的最高數目,合共不得超過不時已發行股票的10%。

於二零二一年十一月二日，本公司已授出合共67,732,000份期權，可認購合共最多67,732,000股股票，其中36,102,680份期權尚未行使。除股票期權計劃外，本公司並無任何其他股票期權計劃。

為使本公司能夠更靈活地向其僱員提供激勵及獎勵，並使本集團能夠吸引及保留人才以支持其長期營運目標，董事會建議將股票期權計劃限額更新為於獲股東在股東特別大會上批准當日的已發行股票的10%。

上市規則涵義

根據上市規則第17.03(3)及(18)條以及股票期權計劃條款，對已授出期權的條款作出任何變動及對股票期權計劃限額作出任何更新，均須獲股東批准。

本公司將於二零二一年十一月二十六日或前後召開股東特別大會，會上將提呈一項普通決議案，以考慮及酌情批准(i)建議修訂二零一八年期權及二零一九年期權的條款及(ii)建議更新股票期權計劃限額。將根據二零一八年期權及二零一九年期權的經修訂條款獲發行股票或以其為受益人發行股票的承授人及其聯繫人將須於股東特別大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)建議修訂二零一八年期權及二零一九年期權的條款及(ii)建議更新股票期權計劃限額的詳情的通函，以及召開股東特別大會的通告，預期將於二零二一年十一月八日或前後寄發予股東。

暫停辦理股票過戶登記通告

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二一年十一月二十三日(星期二)至二零二一年十一月二十六日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理本公司股票過戶登記手續，期間本公司不會進行任何股票過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，務請於二零二一年十一月二十二日(星期一)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓。所有於股東特別大會記錄日期二零二一年十一月二十六日(星期五)為股票登記持有人的人士將有權出席股東特別大會並於會上投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「二零一八年期權」	指	本公司根據股票期權計劃於二零一八年十二月二十四日授出的期權，其詳情載於本公司日期為二零一八年十二月二十七日的公告；
「二零一九年期權」	指	本公司根據股票期權計劃於二零一九年三月二十九日及二零一九年十二月二十三日授出的期權，其詳情分別載於本公司日期為二零一九年三月二十九日及二零一九年十二月二十三日的公告；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	華虹半導體有限公司，一家於二零零五年一月二十一日在香港註冊成立的有限公司，其股票於聯交所主板上市；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將舉行的股東特別大會，以考慮及酌情批准建議修訂二零一八年期權及二零一九年期權的條款以及建議更新股票期權計劃限額；
「息稅折舊及攤銷前利潤」	指	除利息、稅項、折舊及攤銷前之利潤；
「本集團」	指	本公司及其子公司；
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區；
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則；
「期權」	指	根據股票期權計劃條款認購股票的權利；
「股票」	指	本公司的普通股；
「股東」	指	股票持有人；

「股票期權計劃」	指	本公司於二零一五年九月一日在其股東特別大會上採納的股票期權計劃，其主要條款於本公司日期為二零一五年八月十七日的通函中概述；
「股票期權計劃限額」	指	根據股票期權計劃及本公司任何其他計劃將授出的所有期權獲行使時可予發行的股票的最高數目；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「子公司」	指	具有上市規則賦予的涵義；及
「%」	指	百分比。

承董事會命
華虹半導體有限公司
董事長兼執行董事
張素心先生

中國上海，二零二一年十一月四日

於本公告日期，董事分別為：

執行董事：

張素心 (董事長)

唐均君 (總裁)

非執行董事：

孫國棟

王靖

葉峻

獨立非執行董事：

張祖同

王桂壘，太平紳士

葉龍蜚